

檔 號：

保存年限：

國家科學及技術委員會 函

機關地址：臺北市大安區和平東路二段106號
聯絡人：陳家漪
電話：02-2737-7932
傳真：02-2737-7619
電子信箱：cchen22@nstc.gov.tw

受文者：國立臺南護理專科學校

發文日期：中華民國115年4月17日

發文字號：科會產字第1150025290號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：2026未來科技獎徵件須知、2026未來科技獎暨參展報名資料表、2025未來科技獎獲選名單(附件1 115T0P001435_115D2009425-01.pdf、附件2 115T0P001435_115D2009427-01.pdf、附件3 115T0P001435_115D2009426-01.odt)

主旨：有關「2026台灣創新技術博覽會－未來科技館」辦理之未來科技獎徵件自即日起至115年5月17日受理，請查照並轉知所屬踴躍報名。

說明：

一、旨揭博覽會將於115年9月17日（星期四）至9月19日（星期六）於台北世貿一館展出，以成為國際研發交易樞紐平台為定位，由12部會展示前瞻技術能量，並邀請海外機構參展，共同展現我國創新技術能量。

二、未來科技獎徵件說明如下（請詳附件徵選須知）：

(一)報名資格：

- 1、須為本會、中央研究院、教育部、運動部、衛生福利部，前述任一部會補助之計畫成果。
- 2、為符合規定之領域範疇，鼓勵與國家重點發展方向接軌之計畫成果投件。

(二)報名方式與時程：

- 1、系統開放報名時間：即日起至115年5月17日（星期日）前由計畫主持人至未來科技館徵件網址（<https://>

國立臺南護理專科學校



1150003116 115/04/17

award.futuretech.org.tw/) > [技術團隊] 線上登錄報名資料 (請詳附件報名資料表)。

2、受理學校機構發函：115年5月18日(星期一)起，貴單位可於前述徵件網址 > [產學窗口] 下載報名清單，並由貴單位審核推薦，於115年5月21日(星期四)前函送本會。

(三)獲選獎勵：頒發「2026未來科技獎」獎盃、獎狀及獎金新臺幣1萬元整；獲獎技術若為本會計畫，將可列為計畫主持人申請本會計畫加分項目。另為促進國際交流與合作，將依團隊技術屬性提供海外展會或國際交流活動之機會以拓展國際合作商機。

三、本案聯絡窗口：陳小姐，電話(02)2576-2013，信箱：

wenhua@mail.tca.org.tw

正本：專題研究計畫受補助單位 (共254單位)

副本：中央研究院、教育部、運動部、衛生福利部、本會各處室及所屬機關(共27單位)、財團法人國家實驗研究院、財團法人國家同步輻射研究中心、國家災害防救科技中心、國家太空中心、台北市電腦商業同業公會(均含附件)

115/04/17
14:22:01

主任委員吳誠文

「2026 未來科技獎」徵件須知

一、徵件目的：

盤點具高度技術創新與產業發展潛力之科研成果，透過展會展示與媒合平台，促進科研技術與產業研發接軌，加速具產業應用價值之技術落地與合作機會，並展現我國科研成果之國際能見度與科技實力。

二、徵件資格：

(一)須為國家科學及技術委員會(下稱國科會)、中央研究院、教育部、運動部、衛生福利部任一部會補助之計畫成果。

(二)申請計畫成果符合以下技術領域範疇，或扣合國家重點發展方向皆可報名。

1. 自然及永續科技應用(涵蓋基礎科學突破、地球系統觀測與模擬、及永續與防災科技應用)
2. 綠能環保與淨零科技(涵蓋再生能源、儲能、循環經濟與永續發展)
3. 人工智慧應用(涵蓋AI、AIoT、資安、機器人、無人機、智慧製造)
4. 先進材料與化工(涵蓋材料科學、綠色化工、表面科學與薄膜技術)
5. 半導體與光電通訊(涵蓋晶片設計製程、先進封裝、矽光子、次世代通訊、量子技術)
6. 生技與新藥(涵蓋生物醫學、新藥研發、細胞治療)
7. 醫材(涵蓋醫療器材與系統、穿戴式裝置、生物感測、AI智慧醫療)
8. 人文科技應用(涵蓋科技藝術、數位人文、文化科技、運動科技)

三、報名方式及時間：

(一)**系統開放報名時間**：由**計畫主持人**自行線上報名。

- 由計畫主持人自即日起至5/17(日)23:59止至未來科技館徵件網站

(<https://award.futuretech.org.tw/>) > [技術團隊] 註冊帳號或以前年度報名帳號登入。

(二)**機構發函推薦**：由計畫主持人所屬單位將**推薦報名技術清單**以**電子公文函送國科會**。

- 受補助學研單位之產學研發處人員須先至未來科技館徵件網址

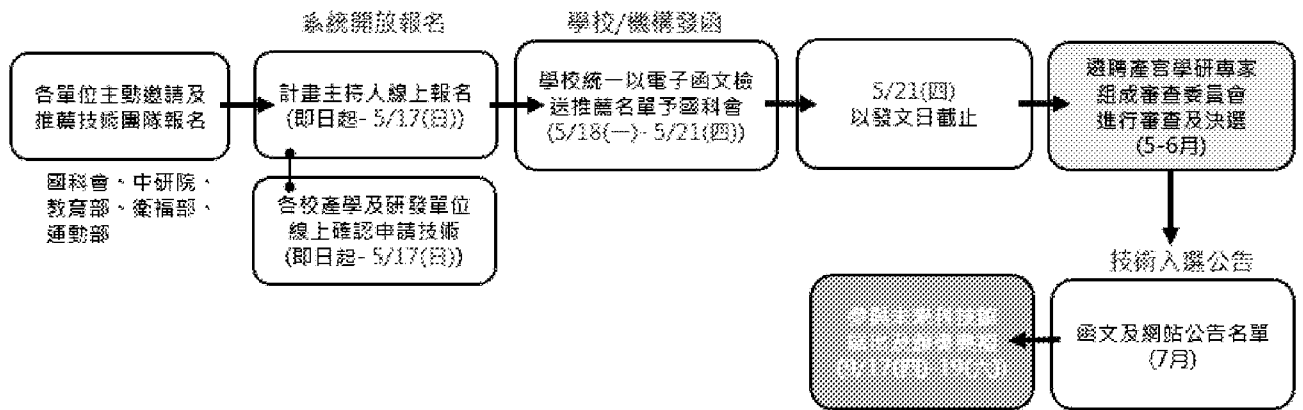
(<https://award.futuretech.org.tw/>) > [產學窗口] 申請管理帳號，5/18(一)起於該網址下

載完整報名清單〔須勾選**推薦**〕，並確認貴機構所有報名技術均為機構持有，於

5/21(四)前以電子公文方式檢送報名清單予國科會。

(三)以上兩步驟皆完成，始完成報名作業。

四、徵件流程：



五、評選標準

(一)技術創新性：

1. 技術原理、架構或方法具明確創新性，並可說明相較現有主流技術 (Benchmark) 之差異與優勢。
2. 已具備概念驗證、原型、模組或實驗數據等可佐證成果。

(二)產業應用性：

1. 技術能回應產業與社會痛點，提供明確解決方案或與使用者需求具高度契合度。
2. 技術導入具提升產業競爭力、促進產業升級或具應用擴散之潛力。

(三)前瞻應用潛力(僅自然及永續科技應用、綠能環保與淨零科技領域適用)：

1. 科技、創新概念或技術具備發展為關鍵技術或新興產業鏈之潛力，能引導未來產業發展趨勢。
2. 科技、創新概念或技術具回應未來產業發展趨勢或重要社會需求之應用可能性。

(四)技術如具有展示性或已申請專利，將酌情給予加分。

六、獲選獎勵：

- (一)獲選技術獲頒「2026 未來科技獎」獎盃 1 座、獎狀 1 張及獎金新臺幣 1 萬元整。
- (二)獲選技術若為國科會計畫，可列為申請國科會部分研究計畫加分項目參考。
- (三)於「2026 台灣創新技術博覽會-未來科技館」展中公開頒獎及技術展示，並獲得宣傳行銷及技術推廣媒合機會。
- (四)為促進國際交流與合作，將依團隊技術屬性提供參與海外展會或國際交流活動之機會，以提升國際能見度與合作連結。
- (五)協助鏈結科研創業計畫、產學合作計畫及相關專業輔導資源，支持獲選技術後續商業化與應用發展。

七、其他注意事項：

- (一)獲選技術應配合「2026 台灣創新技術博覽會-未來科技館」之相關活動安排，包含宣傳露出、實體展出及展後媒合調查回報等事項。展期三日原則上須安排團隊人員於現場

進行技術展示與說明；如經查證展期間未安排人員到場，將予以沒收獎金頒發資格。

- 「2026 台灣創新技術博覽會-未來科技館」展覽資訊如下。

1. 展出時間：9/17(四)-9/19(六)
2. 展出地點：台北世貿一館

(二)獲選技術或計畫主持人如有下列情事之一者，國科會得視情節輕重取消或追回獎項：

1. 獎項申請內容涉及違反學術倫理情事者，依「國家科學及技術委員會學術倫理案件處理及審議要點」規定處理；並請確實遵守智慧財產權相關規定，違者應自負相關法律責任。
2. 計畫主持人如違反性別平等相關法規，經相關主管機關查證屬實或檢察官提起公诉者，國科會得視情節輕重撤銷獎項。

(三)國科會保留修改本辦法之權利，如有未盡事宜，悉依國科會相關規定或解釋辦理。

八、洽詢窗口：

未來科技館推動辦公室 陳小姐

信箱：wenhua@mail.tca.org.tw

電話：(02)2576-2013



「2025 未來科技獎」獲獎名單

■ 共 83 件技術

■ 列名第一位為計畫主持人、標註*為計畫總主持人

序號	申請機構	參展技術名稱	計畫(總)主持人、共同主持人	補助部會
1	國立臺灣大學	AI 嵌入式五軸 CNC 控制器	蔡孟勳*、郭峻因、洪哲倫、林明宗	國家科學及技術委員會
2	國立臺灣大學	iCROSS: 嬰兒心臟機器人輔助手術系統	陳政維、黃書健	國家科學及技術委員會
3	國立臺灣大學	大語言模型強化之商品標註與多模態推薦整合系統	林澤	國家科學及技術委員會
4	國立臺灣大學	次世代化合物半導體之多維度多重物理耦合模擬平台 (DDCC-TCAD)	吳育任*、吳肇欣、黃建璋	國家科學及技術委員會
5	國立臺灣大學	淨零減碳前瞻科技-連續式真空儲冰泥空調系統技術開發研究	呂明璋*、陳希立、羅景文、王榮昌、江沅晉、李文興	國家科學及技術委員會
6	國立臺灣大學	精進機器人大腦：學得快、聽得懂、異常秒察覺	徐宏民*、葉佳峯	國家科學及技術委員會
	國立臺灣大學	臺鵠：臺灣人文知識對話 AI 探勘系統	葉素玲、李宏毅、張智星、傅立成、項潔、蔡宗翰、黃從仁、張素玢、陳冠妃	國家科學及技術委員會
8	國立臺灣大學	應用人工智慧之可變焦超穎光學切片內視顯微系統	駱遠、陳文翔、黃光裕、朱正弘	國家科學及技術委員會
9	國立臺灣大學	元宇宙驅動之延展實境超音波導引侵入性治療與手術訓練系統	郭庭均*、吳明勳	國家科學及技術委員會
10	國立臺灣大學	革命性 CAR-sEV：非基因改造靶向性幹細胞外泌體藥物於精準醫療之應用	王惠鈞*、林泰元、李政忠、黃彥華	國家科學及技術委員會
11	國立臺灣大學	微創無煙電刀	賴碩倫*	國家科學及技術委員會
12	國立清華大學	半導體物質檢測之太赫茲單像素影像加速晶片系統	黃元豪、楊尚樺	國家科學及技術委員會
13	國立清華大學	建築涼感衣-零耗能日間輻射冷卻材料	萬德輝、陳學禮	國家科學及技術委員會
14	國立清華大學	異野漆樹苷及其衍生物用於促進神經修復的用途	陳裕仁、陳令儀*、王翊	國家科學及技術委員會
15	國立清華大學	無線遙控磁電基因遞送凝膠轉染技術應用於腦傷神經 miRNA 海綿基因治療	胡尚秀*、李亦淇、謝明佑、黃兆棋、朱麗安	國家科學及技術委員會

「2025 未來科技獎」獲獎名單

序號	申請機構	參展技術名稱	計畫(總)主持人、共同主持人	補助部會
16	國立清華大學	磁力式串聯彈性致動器應用於可調變剛性手腕復健機器人	張禎元	國家科學及技術委員會
17	國立清華大學	輕量化柔性電磁感應貼片用於非接觸式健康監測	王廷璋*、謝育整	國家科學及技術委員會
18	國立清華大學	應用於先進緒式電晶體邏輯製程三維堆疊超高密度內嵌電阻式記憶體陣列	金雅琴、林崇榮、涂維珍	國家科學及技術委員會
19	國立清華大學	應用於共同封裝光元件之112Gb/s極短距四階脈衝振幅調變傳收機	彭朋瑞*、謝秉璇、劉怡君、林銘偉	國家科學及技術委員會
20	國立清華大學	邁向次世代環保科技：智慧雷射金屬著色	陳鴻文*	教育部
21	國立陽明交通大學	ProDEP：單細胞精準操控自動化平台	李鎮宜	國家科學及技術委員會
22	國立陽明交通大學	共鑑慧眼：即時可信媒體防衛盾	許志仲*、楊政達、曾祥非、張詠淳、蔡家齊	國家科學及技術委員會
23	國立陽明交通大學	供先進節能綠色計算之高擴充、客製化鍍量子點技術	李佩雯*	國家科學及技術委員會
24	國立陽明交通大學	指尖式血糖感測器	趙昌博*、陳秀玲、簡銘男	國家科學及技術委員會
25	國立陽明交通大學	突破邏輯密度極限的單晶片三維異質元件整合與創新材料技術：實現高密度AI運算晶片的關鍵技術平台	劉柏村*、賴宇紳、侯福居	國家科學及技術委員會
26	國立陽明交通大學	針對邊緣運算優化之高效能端對端大型語言模型加速器晶片	黃俊達*	國家科學及技術委員會
27	國立陽明交通大學	高效分散式電動推進垂直起降無人機技術	莊仁輝、賴錦文、程登湖、彭文孝	國家科學及技術委員會
28	國立陽明交通大學	從多視角影片中精準重建三維羽球比賽	王昱舜、彭文志*	國家科學及技術委員會
29	國立陽明交通大學	超寬能隙 p-型氧化鎵	洪瑞華	國家科學及技術委員會
30	國立陽明交通大學	廢棄 PET 升級改造之導電自修復、動態智能環境監測與光感防偽技術	陳俊太	國家科學及技術委員會
31	國立陽明交通大學	應用於心衰竭病人再入院與死亡風險預測之深度異質性多模態學習技術	曾新穆	國家科學及技術委員會
32	國立陽明交通大學	應用於自供電感測器之微機電振盪器陣列渦流誘發振動能量採集裝置	賴錦文	國家科學及技術委員會

「2025 未來科技獎」獲獎名單

序號	申請機構	參展技術名稱	計畫(總)主持人、共同主持人	補助部會
33	國立成功大學	人機共舞：基於電腦視覺之零編程直覺化機械手臂編舞界面暨人機協作創作系統	沈揚庭、陳建旭*、林軒丞、卓彥廷、林峰正、陳明惠	國家科學及技術委員會
34	國立成功大學	以微藻建構減碳與創能之永續航空燃油料源生產平台	陳俊延*、吳意珣	國家科學及技術委員會
35	國立成功大學	多體學導引之胰臟癌精準醫療技術平台	沈延盛*	國家科學及技術委員會
36	國立成功大學	氫向未來綠能革新:非貴金屬 AEMWE 電解技術引領產業脫碳	丁志明*、阮氏川	國家科學及技術委員會
37	國立成功大學	通用型低免疫源性異體 iPSC 種源庫：實現再生醫療產業化與臨床突破	劉嚴文、沈延盛*、顏家瑞、蔡坤哲、許釗凱、李宜珍	國家科學及技術委員會
38	國立成功大學	智慧型移動式水體溫室氣體監測無人平台	林財富*、沈聖智、黃榮振、陳緞紘、郭益銘	國家科學及技術委員會
39	國立成功大學	圖機器學習之 AI 海關進口詐欺偵測技術	李政德*	國家科學及技術委員會
40	國立成功大學	綠色鋼鐵：富氫高爐碳循環技術	林育正、林士剛*、吳紀聖、吳煒、鄭文惠	國家科學及技術委員會
41	國立成功大學	雙模深度學習模型之胃癌前病變精準醫療診斷方法	黃春融、鄭修琦*	國家科學及技術委員會
42	國立成功大學	讓癌細胞自滅的黑科技！「癌細胞斷電」技術	葉晨聖*、蘇文彬、邱文泰、李偉鵬	國家科學及技術委員會
43	國立成功大學	高效捕捉、轉質再利用及碳材開發技術	陳維新*、李冠廷、張家欽、游承修、陳俊延	國家科學及技術委員會
44	國立中山大學	行動式偏振光膚質檢測系統	林宗賢	國家科學及技術委員會
45	國立中央大學	SkyCrypt：應用於智慧無人機系統的姿態驅動無線物理層密鑰生成技術	陳昱嘉	國家科學及技術委員會
46	國立中央大學	光纖陀螺地震儀——邁向多維高精度地震感測技術	陳彥宏、劉正彥*、顏宏元、林慶仁、鍾宏彬、蘇文鈺	教育部
47	國立中央大學	高熵觸媒在海水裂解產氫中的全面研究與產業化開發	洪緯璿、葉均蔚*	教育部
48	國立中正大學	RIS 輔助的 AI-native 6G RAN 通訊系統：改變智慧城市廣域連接技術	連紹宇、張盛富*、張嘉展、林士程、曾志成	國家科學及技術委員會

「2025 未來科技獎」獲獎名單

序號	申請機構	參展技術名稱	計畫(總)主持人、共同主持人	補助部會
49	國立中興大學	3D 封裝接合技術與智慧測控平台	宋振銘*、洪志斌、鍾官榮	國家科學及技術委員會
50	國立中興大學	應用於智慧健康與環境監測之新型摻錫氧化鎵薄膜高效能一氧化氮氣體感測器	武東星、林偉立、余飛鵬	國家科學及技術委員會
51	國立中興大學	環境友善低碳多功能智慧醫療敷料整合人工智慧創新技術應用	林耀東*、黃振文、吳俊霖、翁誌煌、黃祥閔	國家科學及技術委員會
52	國立宜蘭大學	可規模化的觸媒 3D 列印全製程開發：實踐化工反應床設計與製造的智慧轉型	陳建樺、陳華偉、胡哲嘉	國家科學及技術委員會
53	國立高雄大學	鈣厲害！蛋殼轉化在高值化環保觸媒和先進醫材的應用	鍾宜璋*、鄧宗誠	國家科學及技術委員會
54	國立嘉義大學	提升雞隻生產效益「減少碳足跡」	陳國隆*、翁博群、魏佳俐、李宗育	國家科學及技術委員會
55	國立臺灣科技大學	多尺度 3D 列印可撓式觸覺感測器，應用於可穿戴式人機互動與智慧運動。	陳品銓*	國家科學及技術委員會
56	國立臺灣科技大學	非貴金屬觸媒引領天然氣電解與氧化暨燃料電池之應用	王丞浩*	中央研究院
57	國立臺灣科技大學	高面積使用效率之可操作於低電壓的稀疏神經網路加速器	李佩君、蔡宗漢*	國家科學及技術委員會
58	國立臺灣科技大學	智慧型口語表達輔助系統	曾厚強、陳素芬*、陳冠宇	教育部
59	國立臺灣科技大學	應用於碳捕捉之中空纖維薄膜設計與先進選擇層材料開發	鍾台生	國家科學及技術委員會
60	國立臺北科技大學	用於偵測詐騙之語音辨識方法	鍾建屏、花凱龍、張智星、李修全、陳昱欣	國家科學及技術委員會
61	國立臺北科技大學	亞太赫茲高解析度且具有穿透性之動態電磁結構安全分析檢測設備	鍾明桉、	國家科學及技術委員會
62	中國醫藥大學	多類型基因精準遞送之間質幹細胞平台建構：跨癌種精準免疫療法的新策略	徐偉成、鄭隆賓*、許斐婷	國家科學及技術委員會
63	中國醫藥大學	治療性人源化 CD24 單株抗體應用於三陰性乳癌的精準免疫標靶治療	詹世萱、王陸海*	國家科學及技術委員會
64	中國醫藥大學	靶向性外泌體新藥平台：核酸與化療藥物遞送之奈米載體	陳怡文、周德陽*、謝明佑、邱紹智、潘志明、黃士維	國家科學及技術委員會

「2025 未來科技獎」獲獎名單

序號	申請機構	參展技術名稱	計畫(總)主持人、共同主持人	補助部會
65	中國醫藥大學暨附設醫院	以甲基化 EGFR 為三陰性乳癌腫瘤生物標記及癌症標靶	王紹椿、洪明奇*、林志偉、林佑哲、李浚維、沈宜君	教育部
66	元智大學	次世代 PEM 電解技術製低碳臭氧與負碳綠氫	鐘國濱、余浚璋	國家科學及技術委員會
67	長庚大學	智慧心律變異度分析預測敗血性休克模型	吳進結、陳冠甫*、陳淑惠	國家科學及技術委員會
68	高雄醫學大學附設中和紀念醫院	氣管內管位置異常警示系統	蔡明儒、王照元*	國家科學及技術委員會
69	臺北醫學大學	AI 失智症互動式評估與治療系統	陳兆煒	國家科學及技術委員會
70	臺北醫學大學	正子攝影之機器學習量化定位系統及其運作方法	彭徐鈞	國家科學及技術委員會
71	臺北醫學大學	非接觸式 AI 臨床預警系統：強化壓傷風險照護品質與安全的創新解方	李友專*、黃芝瑋、楊軒佳	國家科學及技術委員會
72	臺北醫學大學	前瞻性穿顱干擾波：開啟非侵入式深腦刺激的新篇章	彭志維、林伯星、吳軍緯、李昱廷、邱劭竹	國家科學及技術委員會
73	臺北醫學大學	腫瘤數位孿生 AI	陳震宇*、張資昊	國家科學及技術委員會
74	長庚醫療財團法人	骨盆靜脈鬱血之非對比磁振造影診斷與血流分析系統	陳建瑋、黃耀廣、許尹禎、王士崇	國家科學及技術委員會
75	長庚醫療財團法人	創新式心房耳無導線節律器之固定器	褚柏顯*	國家科學及技術委員會
76	長庚醫療財團法人	腹腔鏡無網片式疝氣針	王世憲*、何東儒	國家科學及技術委員會
77	臺北榮民總醫院	人工智慧血液透析即時監測預警系統	朱原嘉、唐德成*、郭振宗、歐朔銘、戴辛翎	國家科學及技術委員會
78	財團法人國家衛生研究院	ReMIND AI 輔助精神疾病數位療法	廖倫德、許靖涵	國家科學及技術委員會
79	財團法人農業科技研究院	新世代發光二極體降解有害物質技術創新應用於傳統肉攤與肉品門市環控	洪紹文、楊忠達、倪千祥、邱慶豐、陳嘉琪	國家科學及技術委員會
80	工業技術研究院	SmartEHR Coder：基於大語言模型的電子病歷自動臨床編碼支援系統	張慈映、李建璋*、李青憲	衛生福利部
81	中央研究院	利用金屬奈米結構與對比式表面電漿影像技術進行藥物毒性定量分析	魏培坤*、侯憲三、李光立、鄭邕言	中央研究院

「2025 未來科技獎」獲獎名單

序號	申請機構	參展技術名稱	計畫(總)主持人 、共同主持人	補助部會
82	中央研究院	雄激素代謝益生菌之創新開發：針對高雄激素血症的功能性腸道微生物療法	江殷儒*、陳美州、蕭尊先、李宗徽、陳宜龍	國家科學及技術委員會
83	衛生福利部	基於大語言模型的高風險兒童自動化語意分析風險評估系統	吳祐綺、李建璋*	衛生福利部



「2026 未來科技獎」暨參展報名資料表

線上登錄網址：<https://award.futuretech.org.tw/>

一、技術團隊基本資料

*為必填欄位

※請依當初申請補助計畫填列之申請單位及計畫團隊成員資料填寫

申請單位名稱全名 (中文)*	ex: 國立臺灣大學		
申請單位名稱全名 (英文)*	ex: National Taiwan University		
單位統一編號*			
單位地址(中文)*			
單位地址(英文)*			
單位網址			
計畫總主持人 (無則免填) *將列名於獲獎公告	部門/科系	單位名稱	
信箱	職稱		
計畫主持人* *將列名於獲獎公告	單位名稱*		
部門/科系*	職稱*		
連絡電話*	分機	手機*	
信箱*	ex: 02-2578-6427		
計畫共同主持人 (無則免填，可自行增加欄位，至多8位) *將列名於獲獎公告	單位名稱		
職稱	信箱		
聯絡人(中文)*	聯絡人(英文)*		

職稱(中文)*		職稱(英文)*	
部門/科系*		聯絡電話*	ex: 02-2578-6427 分機
手機*		信箱*	

二、技術內容

技術名稱*	中文	※此技術名稱將作為展覽現場看板標題、廣宣使用，請提供確切及完整技術名稱
	英文	※此技術名稱將作為展覽現場看板標題、廣宣使用，請提供確切及完整技術名稱
技術來源*	<input type="checkbox"/> 國家科學及技術委員會 <input type="checkbox"/> 中央研究院 <input type="checkbox"/> 教育部之公私立大專院校 <input type="checkbox"/> 衛生福利部 <input type="checkbox"/> 運動部 計畫編號：_____，計畫名稱：_____ (請詳列年度/計畫全名) 計畫經費：_____萬元 *請勿輸入千分位分隔符號(.) 補助單位：(下拉式選單) <input type="checkbox"/> 自然科學及永續研究發展處 <input type="checkbox"/> 工程技術研究發展處 <input type="checkbox"/> 生命科學研究發展處 <input type="checkbox"/> 人文及社會科學研究發展處 <input type="checkbox"/> 科教發展及國際合作處 <input type="checkbox"/> 前瞻及應用科技處 <input type="checkbox"/> 產學及園區業務處 <input type="checkbox"/> 綜合規劃處 <input type="checkbox"/> 若無計畫編號，請提供專案或補助計畫名稱：_____ (請詳列:年度/專案及計畫全名/計畫經費)	
資料類別*	<input type="checkbox"/> 技術 <input type="checkbox"/> 專利 <input type="checkbox"/> 其他_____	
技術 TRL 等級* (單選)	<input type="checkbox"/> TRL1 <input type="checkbox"/> TRL2 <input type="checkbox"/> TRL3 <input type="checkbox"/> TRL4 <input type="checkbox"/> TRL5 <input type="checkbox"/> TRL6 <input type="checkbox"/> TRL7 <input type="checkbox"/> TRL8 <input type="checkbox"/> TRL9	
獲獎紀錄*	<input type="checkbox"/> 是，請條列本技術相關獲獎紀錄(含獲獎年度) <input type="checkbox"/> 否	
參展技術類別* (單選)	<input type="checkbox"/> 自然及永續科技應用 <input type="checkbox"/> 綠能環保與淨零科技 <input type="checkbox"/> 人工智慧應用 <input type="checkbox"/> 先進材料與化工 <input type="checkbox"/> 半導體與光電通訊 <input type="checkbox"/> 生技與新藥 <input type="checkbox"/> 醫材 <input type="checkbox"/> 人文科技應用	
參選技術是否與下列領域議題相關*	<input type="checkbox"/> 半導體 <input type="checkbox"/> AI <input type="checkbox"/> 機器人 <input type="checkbox"/> 量子科技 <input type="checkbox"/> 淨零科技 <input type="checkbox"/> 精準健康 <input type="checkbox"/> 太空科技 <input type="checkbox"/> 無關聯	
是否已登記成立新創公司*	<input type="checkbox"/> 是，登記公司名稱：_____ <input type="checkbox"/> 否	

技術說明(中文)* (限 1000 字元數，含空白)	
技術簡介(中文)* (限 150 字元數，含空白)	※此欄內容將作為技術手冊及展覽現場看板使用，故有字數限制
技術說明(英文)* (限 2000 字元數，含空白)	
技術簡介(英文)* (限 500 字元數，含空白)	※此欄內容將作為技術手冊及展覽現場看板使用，故有字數限制
技術創新性說明(中文) (限 1000 字元數，含空白)	※此欄請說明技術之核心創新重點或潛力，以及與國內外相關技術之差異或優勢。(如實驗數據、效能指標、方法或架構比較)
技術創新性概述(中文) (限 150 字元數，含空白)	※此欄內容將作為技術手冊編排使用，故有字數限制
技術創新性概述(英文) (限 500 字元數，含空白)	※此欄內容將作為技術手冊編排使用，故有字數限制
產業應用性說明*(中文) (限 1000 字元數，含空白)	※此欄請說明技術欲回應之產業痛點或實務需求，並描述可應用之產業情境、對象或使用場域，說明其相較現行作法之改善重點與應用價值。(如已有合作或應用經驗，可補充說明)
產業應用性概述(中文)* (限 150 字元數，含空白)	※此欄內容將作為技術手冊編排使用，故有字數限制
產業應用性概述(英文)* (限 500 字元數，含空白)	※此欄內容將作為技術手冊編排使用，故有字數限制
前瞻應用潛力說明*(中文) (限 1000 字元數，含空白)	※ <u>僅自然及永續科技應用、綠能環保與淨零科技領域適用</u> ※此欄請說明技術未來於產業或社會情境中的應用可能性，並評估其轉化為關鍵技術或催生新興產業之潛力。或提出該技術如何對應未來產業趨勢或解決重大社會需求之可能性。
前瞻應用潛力概述(中文)* (限 150 字元數，含空白)	※ <u>僅自然及永續科技應用、綠能環保與淨零科技領域適用</u> ※此欄內容將作為技術手冊編排使用，故有字數限制
前瞻應用潛力概述(英文)* (限 500 字元數，含空白)	※ <u>僅自然及永續科技應用、綠能環保與淨零科技領域適用</u> ※此欄內容將作為技術手冊編排使用，故有字數限制
技術展示方式*	

(限 1000 字元數，含空白)		※請詳細描述技術展示方式，包含 Prototype 展示方式、互動可能性，如有實體展示請描述物品大小(長*寬*高)																																																																					
技術差異性說明 (限 1000 字元數，含空白) (非必填)		※如計畫主持人近三年曾獲未來科技獎，或曾以同一技術重複報名，請說明重複申請技術之差異性																																																																					
技術關鍵字* (中文)		※請提供 10 組中文關鍵字，供媒合廠商透過關鍵字，精準快速搜尋此技術																																																																					
技術關鍵字* (英文)		※請提供 10 組英文關鍵字，供媒合廠商透過關鍵字，精準快速搜尋此技術																																																																					
專利保護狀況 (非必填)	申請中	申請國別	專利類型	申請號																																																																			
	已獲證	核准國家	專利類型	證書號碼	專利權止日																																																																		
技術媒合模式* (可複選)		<input type="checkbox"/> 專利非專屬授權 <input type="checkbox"/> 專利專屬授權 <input type="checkbox"/> 專利讓與 <input type="checkbox"/> 技術移轉 <input type="checkbox"/> 合作開發 <input type="checkbox"/> 產學合作 <input type="checkbox"/> 技術投資 <input type="checkbox"/> 成立新創 <input type="checkbox"/> 其他 _____ <input type="checkbox"/> 無媒合意願																																																																					
首次發表* (單選)		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 ※如技術尚未於任何公開形式發表過，即為首次發表																																																																					
技術發明人* *將列名於獎狀製作 (請依實際貢獻核實填列，至多 10 位)		發明人數：_____ (至多 10 位) *英文姓名格式：名在前、姓氏在後。名字音節中間以短橫區隔。 ex：王小明 SIAO-MING WANG																																																																					
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">姓名</th> <th colspan="2">單位</th> <th colspan="2">職稱</th> </tr> <tr> <th>中文</th> <th>*英文</th> <th>中文</th> <th>英文</th> <th>中文</th> <th>英文</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>				姓名		單位		職稱		中文	*英文	中文	英文	中文	英文																																																						
姓名		單位		職稱																																																																			
中文	*英文	中文	英文	中文	英文																																																																		
技術/產品圖片*		請上傳 3 張圖片，規格為 jpg、png、gif、1024*768 像素(150dpi)含以上，1MB 以內																																																																					

技術影片(非必填)	<input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有，影片連結：_____
附件資料	<input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有， <u>上傳附件佐證資料，如計畫書、國際期刊、專利或其他可加分之佐證資料。</u> (請先將相關佐證資料統一輸出成乙份PDF檔案，檔案大小限制於5M內)
備註	

